

低損失多層FPC（GHz帯）

製品特徴

- ・ポリイミドに比べ低誘電特性を持つLCPは、誘電正接も低い為長い回路でも信号が減衰しにくく正確に伝送することが可能です。
- ・オールLCP基板は長期耐熱性にも優れUL規格(796F)のMOT180°C相当の試験でも柔軟性を保持することが可能です。

試験方法：230°Cで240時間の劣化試験後 直径6.275mmのピンゲージに5回巻きつけて状態を確認する。

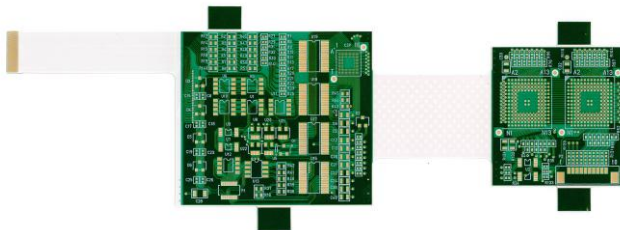
オールLCP 試験後



ポリイミドFPC 試験後(接着剤のひび割れ発生)



製品写真



LCP一般特性表

| 試験項目 | 処理条件 | LCP50μ m,Cu18μ | 単位 |
|-------|-------------|----------------|----|
| 比誘電率 | 2GHz | 3.0 | - |
| | 10GHz | 3.0 | - |
| 誘電正接 | 2GHz | 0.0008 | - |
| | 10GHz | 0.0016 | - |
| 吸水率 | 25°C50h浸漬 | 0.04 | % |
| 寸法安定性 | エッチング後 MD方向 | 0.001 | % |
| | エッチング後 TD方向 | -0.005 | % |

製品構成例

| | | 単位(μ m) | |
|-------------|--|---------|--------------|
| 50 LCPカバーレイ | | | L1 液レジ |
| | | 33 | L1 銅箔+銅メッキ |
| | | 50 | L1 ベース LCP |
| 40 接着剤 | | 50 | L2 LCP カバーレイ |
| 180 補強板 | | 18 | L2 銅箔 |
| | | 50 | ベース LCP |
| | | 18 | L3 銅箔 |
| | | 50 | L3 LCP カバーレイ |
| | | 50 | L4ベース LCP |
| | | 33 | L4 銅箔+銅メッキ |
| | | 50 | L4 LCP カバーレイ |
| | | 402 | |

[お問合せ] TEL.046-251-3722 FAX.046-251-3725
 [ホームページ] <http://www.yamashita-net.co.jp>
 [E-mail] cc@yamashita-net.co.jp

 YAMASHITA MATERIALS